

水谷電機

重量・体積60%削減

産業機器用
ヒートシンク
制御盤向け提案

水谷電機工業（東京都千代田区、水谷典央社長、03・3255・4600）は、同社従来品

に比べ小型・軽量化した産業機器向けヒートシンク「JフィンII写真」を発売した。独自方式を採用し、フィンの厚みを同約70%薄くして重量、体積とも同約60%削減した。価格は見積もり。産業機器の制御盤用に提案し、初年度約10万台の販売を目指す。

同ヒートシンクはフィンの端部を折り返して厚

みをもたせてヒートシンクの基板の溝にはめ込む独自方式を採用した。フィンと基板の溝の密着度が増すため、薄いフィンでも設置できる。フィンのピッチ間隔を短くして小型化も図った。一方、ヒートシンク一台当たりにはめ込むフィンの枚数を約2倍に増やし、同社従来品と同等の放熱性を実現した。